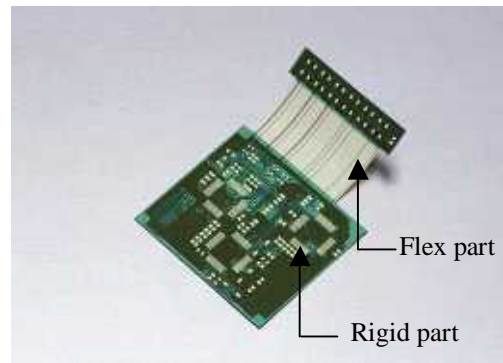
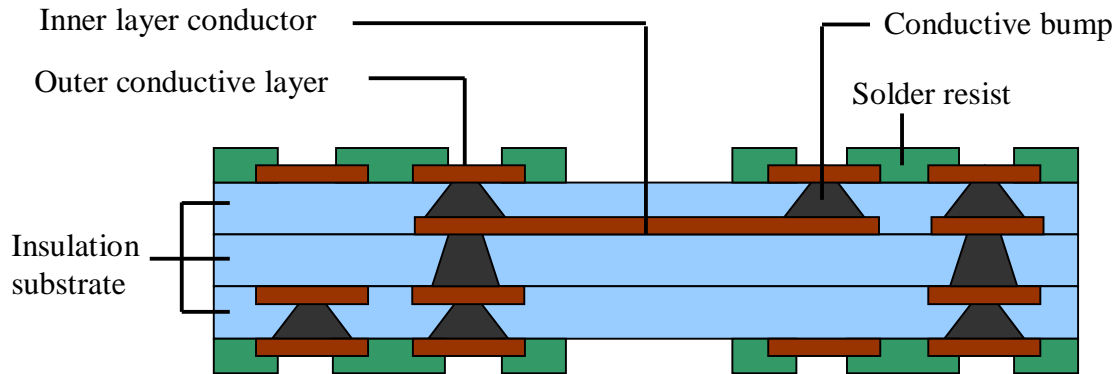


LCP applied to All dielectric layers

Thin circuit board. Rigid part:230 μ m th. Flex part:150 μ m th.

Schemati cross section



Design rule for multi layer

項目	最小
L / S	75 μ m / 75 μ m
ランド径	450 μ m
内層バンプ径	150 μ m
外層バンプ径	250 μ m
バンプピッチ	525 μ m

Material

絶縁基材	液晶ポリマー (厚さ: 50 μ m)
内層導体	電解銅箔 (厚さ: 12 μ m)
外層導体	電解銅箔 (厚さ: 18 μ m)
ソルダーレジスト	UV硬化タイプ